

2023-2029年半导体市场深度调查分 析及发展前景研究报告

产业调研网

www.cir.cn

一、基本信息

报告名称： 2023-2029年半导体市场深度调查分析及发展前景研究报告

报告编号： 1390959 ← 咨询订购时，请说明该编号

报告价格： 电子版：8500 元 纸质+电子版：8800 元

优惠价格： 电子版：7650 元 纸质+电子版：7950 元 可提供增值税专用发票

咨询热线： 400 612 8668、010-66181099、66182099、010-66183099

电子邮箱： kf@Cir.cn

详细内容： <https://www.cir.cn/9/95/BanDaoTiHangYeFenXiBaoGao.html>

提示信息： 如需订阅英文、日文等其它语言版本，请向客服咨询。

二、内容介绍

半导体行业是现代信息技术的基础，涵盖了集成电路、分立器件等多个领域。近年来，随着5G通信、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展，半导体行业迎来了前所未有的发展机遇。目前，半导体行业正处于从摩尔定律向后摩尔时代过渡的关键时期，面临着工艺节点缩小带来的技术挑战。与此同时，随着全球半导体供应链的调整，本土化生产成为许多国家和地区的重要战略之一，促使半导体产业布局发生重大变化。

未来，半导体行业的发展将更加注重技术创新和产业链协同。一方面，随着量子计算、第三代半导体材料等前沿技术的研究取得进展，半导体行业将不断探索新的技术路径，以克服现有技术瓶颈；另一方面，随着全球半导体产业生态的变化，行业内部的合作与整合将变得更加重要，以确保供应链的稳定性和安全性。此外，随着可持续发展意识的提高，半导体行业将更加注重节能减排和绿色制造，推动行业向着更加环保的方向发展。整体而言，半导体行业将在技术创新和产业链优化的双重推动下实现持续增长。

第一章 半导体的概述

第一节 半导体行业的简介

- 一、半导体
- 二、本征半导体
- 三、多样性及分类

第二节 半导体中的杂质

- 一、pn结
- 二、半导体掺杂
- 三、半导体材料的制造

第三节 半导体的历史及应用

- 一、半导体的历史
- 二、半导体的应用
- 三、半导体的应用领域

第二章 半导体行业的发展概述

第一节 半导体行业历程

- 一、中国半导体市场规模成长过程
- 二、全球半导体行业市场简况
- 三、中国半导体行业市场简况
- 四、中国在国际半导体行业地位
- 五、全球半导体行业市场历程

第二节 中国集成电路回顾与展望

- 一、十年发展迈上新台阶
- 二、机遇与挑战并存
- 三、着力转变产业发展方式
- 四、充分推动国际合作与交流

第三节 半导体行业的十年变化

- 一、半导体产业模式fablrite的新思维
- 二、全球代工版图的变化
- 三、推动产业发展壮大的捷径
- 四、三足鼎立
- 五、两次革命性的技术突破
- 六、尺寸缩小可能走到尽头
- 七、硅片尺寸的过渡
- 八、3d封装与tsv最新进展
- 九、未来半导体行业的趋向

第三章 化合物半导体电子器件研究与进展

第一节 化合物半导体电子器件的出现

- 一、化合物半导体电子器件简述
- 二、化合物半导体电子器件发展过程
- 三、化合物半导体电子器件发展难题

第二节 化合物半导体领域发展现状

- 一、化合物半导体领域研究背景
- 二、化合物半导体领域发展现状
- 三、关注化合物半导体的一些难题

第三节 化合物半导体的未来趋势

- 一、引领信息器件频率、
- 二、高迁移率化合物半导体材料
- 三、支撑信息科学技术创新突破
- 四、引领绿色微电子发展
- 五、化合物半导体的期望

第四章 功率半导体技术与发展

第一节 功率半导体概述

- 一、功率半导体的重要性
- 二、功率半导体的定义与分类

第二节 功率半导体技术与发展状况

- 一、功率二极管
- 二、功率晶体管
- 三、晶闸管类器件
- 四、功率集成电路
- 五、功率半导体发展探讨

第五章 半导体集成电路技术与发展

第一节 半导体集成电路的总体情况

- 一、集成电路产业链格局日渐完善
- 二、集成电路设计产业集群效应日益凸现
- 三、集成电路设计技术水平显著提高
- 四、人才培养和引进开始显现成果

第二节 集成电路设计

- 一、自主知识产权cpu
- 二、第三代移动通信芯片
- 三、数字电视芯片
- 四、动态随机存储器
- 五、智能卡专用芯片
- 六、第二代居民身份证芯片

第三节 集成电路制造

- 一、极大规模集成电路制造工艺
- 二、技术成果推动了集成电路制造业的发展
- 三、面向应用的特色集成电路制造工艺

第四节 半导体集成电路封装

- 一、半导体封装产业的历程

二、集成电路封装产业保持增长

三、集成电路封装的突破

四、集成电路封装的发展

第六章 全球半导体行业经济分析

第一节 金融危机后的半导体行业

一、美国经济恶化将影响全球半导体行业

二、日本大地震影响全球半导体产业链上游

三、全球半导体行业仍呈稳健成长趋势

四、全球经济刺激计划带动半导体行业复苏

五、全球半导体行业经济复苏中一马当先

第二节 全球半导体行业经济数据透析

第七章 全球半导体行业的发展趋势

第一节 半导体行业发展方向

一、半导体硅周期放缓

二、半导体产业将是独立半导体公司的天下

三、推动未来半导体产业增长的主动动力

四、摩尔定律不再是推动力

五、soc已经遍地开花

六、整合、

七、私募股份投资公司开始瞄准业界

八、无晶圆厂ic公司越来越发达

第二节 新世纪mems技术创新发展

一、mems技术的发展

二、新兴mems器件的发展

三、发展的机遇

第三节 半导体集成电路产业的发展

一、集成电路历史发展概况

二、世界集成电路产业发展的一些特点和趋势

三、集成电路产业的机遇和挑战

四、集成电路产业发展及对策建议

五、中国集成电路产业发展路径

六、集成电路产业展望

第四节 全球半导体行业的障碍及影响因素

一、半导体行业主要障碍

二、影响半导体行业发展的因素

第八章 中国半导体行业的经济及政策分析

第一节 中国半导体行业的冲击

- 一、上海半导体制造设备进口主要特点
- 二、上海半导体制造设备进口激增的原因
- 三、强震造成的问题及建议

第二节 半导体行业经济发展趋势明朗

- 一、我国半导体行业高度景气阶段
- 二、我国半导体行业快速增长原因分析
- 三、我国半导体行业增长将常态化
- 四、半导体行业蕴藏机会

第三节 半导体行业政策透析

- 一、中国半导体产业发展现状
- 二、中国半导体的优惠扶持政策
- 三、中国大陆半导体产业的政策尴尬

第九章 中国半导体行业机会

第一节 产业分析

- 一、太阳能电池产业
- 二、igbt产业
- 三、高亮led产业
- 四、光通信芯片产业

第二节 中国半导体产业面临发展机会

- 一、太阳能电池产业发展现状
- 二、中国igbt产业市场发展潜力
- 三、高亮led产业
- 四、光通信芯片产业

第十章 中国半导体集成电路产业的发展与展望

第一节 北京集成电路产业

- 一、北京集成电路产业发展回顾
- 二、北京集成电路产业发展展望

第二节 江苏省集成电路产业发展与展望

- 一、江苏省集成电路产业发展回顾
- 二、江苏省集成电路产业发展环境
- 三、江苏省集成电路产业发展展望

第三节 上海集成电路产业发展与展望

- 一、十年辉煌成果

- 二、上海集成电路产业在全球、
- 三、上海集成电路产业发展环境日益优越
- 四、上海集成电路产业的美好发展前景

第四节 深圳集成电路产业发展与展望

- 一、地区产业发展
- 二、产业结构与技术创新能力
- 三、资源优化与整合经验
- 四、地区产业发展环境
- 五、深圳ic设计产业在“十三五”期间的发展目标

第五节 中国半导体行业在创新中发展

- 一、2023-2029年产业发展状况
- 二、产业发展面临的问题
- 三、产业发展的任务

第十一章 中国半导体企业的发展状况

第一节 中国南玻集团股份有限公司

- 一、公司概况
-
- 三、公司未来发展

第二节 方大集团股份有限公司

- 一、公司概况
-
- 三、公司未来发展

第三节 有研半导体材料股份有限公司

- 一、公司概况
-
- 三、公司未来发展

第四节 吉林华微电子股份有限公司

- 一、公司概况
-
- 三、公司未来发展

第五节 南通富士通微电子股份有限公司

- 一、公司概况
-
- 三、公司未来发展

第六节 江西联创光电科技股份有限公司

- 一、公司概况

.....

三、公司未来发展

第七节 上海贝岭股份有限公司

一、公司概况

.....

三、公司未来发展

第八节 天水华天科技股份有限公司

一、公司概况

.....

三、公司未来发展

第九节 宁波康强电子股份有限公司

一、公司概况

.....

三、公司未来发展

第十节 大恒新纪元科技股份有限公司

一、公司概况

.....

三、公司未来发展

第十二章 2023-2029年半导体行业发展环境

第一节 创新是半导体行业发展的推动力

一、延续平面型cmos晶体管—全耗尽型cmos技术

二、采用全新的立体型晶体管结构

三、新沟道材料器件

四、新型场效应晶体管

第二节 硅芯片业的重要动向

一、从apple和intel二类it公司转型说起

二、软硬融合

三、业务融合

四、服务至上

第三节 2023-2029年半导体行业预测

第四节 中^智^林^：半导体产业三大发展趋势

一、多样化

二、平台化发展

三、低功耗到云端

图表 2017-2022年我国集成电路销售额及增长率

图表 2017-2022年我国集成电路设计业、制造业和封测业销售收入情况

图表 2017-2022年台积电全球代工市场份额

图表 2023年全球代工排名

图表 硅片尺寸过渡与生存周期

图表 “申威1” 处理器

图表 “申威1600” 处理器

图表 “神威蓝光” 高性能计算机系统

图表 国家首款卫星数字电视信道接收芯片gx1101及高频头

图表 国家首款有线数字电视信道接收芯片gx1001及高频头

图表 国家首款数字视频后处理芯片gx2001及应用开发板

图表 国产首款解调解码soc芯片gx6101构成的开发板

图表 cx1501+gx3101构成dtmb/avs双国际机顶盒

图表 国产动态随机存储器芯片

图表 山东华芯ddr2芯片构筑的内存条及应用

图表 2023年封装市场企业数量统计

图表 我国主要ic封测企业

图表 我国主要半导体分立器件封测企业

图表 我国主要封装测试设备与模具生产企业

图表 我国主要led封装企业

图表 国内主要金属、陶瓷封装企业

图表 国内电子封装技术教育资源

图表 国内集成电路封装测试业统计表

图表 国内封装测试企业的地域分布情况

图表 2023年中国半导体创新产品和技术ic封装与测试技术

图表 日本国内主要半导体企业受大地震影响情况

图表 我国半导体行业销售增长情况

图表 我国半导体行业销售利润率增长情况

图表 我国集成电路产量及同比增长情况

图表 我国半导体分立器件产量及同比增长情况

图表 我国集成电路出口及贸易平衡情况

图表 全球电脑季度出货量及同比增长情况

图表 全球智能手机季度出货量及同比增长情况

图表 全球半导体行业销售收入及同比增长情况

图表 全球半导体行业产能利用率情况

图表 全球半导体设备订单出货比变化情况

图表 我国主要半导体产品市场价格指数走势情况

图表 我国集成电路销售收入及同比增长情况

图表 全球计算机出货量及同比增长情况

图表 我国集成电路出口额及同比增长情况

图表 2017-2022年ic进口额及占比

图表 2023年电子元器件价格指数

图表 螺纹管hrb33520mm上海市场行情

图表 2017-2022年北京集成电路销售收入及增长率

图表 2017-2022年北京集成电路产业各环节

图表 2017-2022年北京集成电路制造企业销售收入及增长率

图表 2017-2022年北京集成电路封装和测试企业销售收入及增长率

图表 2017-2022年北京集成电路产业装备材料企业销售收入及增长率

图表 江苏省半导体企业风分布

图表 2017-2022年江苏省集成电路产业销售收入

图表 2017-2022年江苏省半导体分立器件销售收入

图表 2017-2022年江苏省半导体分立器件销售收入占全国同业比重

图表 2017-2022年江苏省集成电路产业销售收入占全国同业比重

图表 2017-2022年的十年间上海集成电路产业销售规模和增长率

图表 2017-2022年上海集成电路产量规模

图表 2017-2022年上海集成电路产业出口额变化

图表 2017-2022年上海集成电路产业累积投资额

图表 2017-2022年上海集成电路产业的企业数量及从业人数

图表 2017-2022年上海集成电路产业技术水平

图表 2017-2022年上海集成电路产业占全球、全国半导体产业的比重

图表 2023-2029年上海集成电路产业的销售规模及增长率

图表 2017-2022年深圳ic设计企业销售额

图表 2023年销售额前25名深圳ic设计企业

图表 2023年深圳集成电路设计企业人数分布

图表 深圳市典型ic设计企业设计水平

图表 深圳市ic设计企业特征线宽分布

图表 深圳市ic设计企业ip使用情况

图表 2017-2022年深圳集成电路设计企业销售额

图表 2017-2022年深圳市ic设计机构数量

图表 深圳ic制造企业情况

图表 2017-2022年半导体销售额增长情况

图表 2017-2022年集成电路销售额增长情况

.....

图表 2022-2023年中国南玻集团股份有限公司偿债能力分析

图表 2022-2023年中国南玻集团股份有限公司资本结构分析

图表 2022-2023年中国南玻集团股份有限公司经营效率分析

图表 2022-2023年中国南玻集团股份有限公司获利能力分析

图表 2022-2023年中国南玻集团股份有限公司发展能力分析

图表 2022-2023年中国南玻集团股份有限公司现金流量分析

图表 2022-2023年中国南玻集团股份有限公司投资收益分析

图表 2023年中国南玻集团股份有限公司资产负债分析

图表 2023年中国南玻集团股份有限公司利润分配分析

图表 2022-2023年方大集团股份有限公司偿债能力分析

图表 2022-2023年方大集团股份有限公司资本结构分析

图表 2022-2023年方大集团股份有限公司经营效率分析

图表 2022-2023年方大集团股份有限公司现金流量分析

图表 2022-2023年方大集团股份有限公司投资收益分析

图表 2022-2023年方大集团股份有限公司获利能力分析

图表 2022-2023年方大集团股份有限公司发展能力分析

图表 2023年方大集团股份有限公司资产负债分析

图表 2023年方大集团股份有限公司利润分配分析

图表 2022-2023年有研半导体材料股份有限公司偿债能力分析

图表 2022-2023年有研半导体材料股份有限公司资本结构分析

图表 2022-2023年有研半导体材料股份有限公司经营效率分析

图表 2022-2023年有研半导体材料股份有限公司现金流量分析

图表 2022-2023年有研半导体材料股份有限公司获利能力分析

图表 2022-2023年有研半导体材料股份有限公司发展能力分析

图表 2022-2023年有研半导体材料股份有限公司投资收益分析

图表 2023年有研半导体材料股份有限公司资产负债分析

图表 2023年有研半导体材料股份有限公司利润分配分析

图表 2022-2023年吉林华微电子股份有限公司偿债能力分析

图表 2022-2023年吉林华微电子股份有限公司资本结构分析

图表 2022-2023年吉林华微电子股份有限公司经营效率分析

图表 2022-2023年吉林华微电子股份有限公司现金流量分析

图表 2022-2023年吉林华微电子股份有限公司获利能力分析

图表 2022-2023年吉林华微电子股份有限公司发展能力分析

图表 2022-2023年吉林华微电子股份有限公司投资收益分析

图表 2023年吉林华微电子股份有限公司资产负债分析

图表 2023年吉林华微电子股份有限公司利润分配分析

图表 2022-2023年南通富士通微电子股份有限公司偿债能力分析

图表 2022-2023年南通富士通微电子股份有限公司资本结构分析

图表 2022-2023年南通富士通微电子股份有限公司获利能力分析

图表 2022-2023年南通富士通微电子股份有限公司发展能力分析

图表 2022-2023年南通富士通微电子股份有限公司投资收益分析

图表 2022-2023年南通富士通微电子股份有限公司现金流量分析

图表 2022-2023年南通富士通微电子股份有限公司经营效率分析

图表 2023年南通富士通微电子股份有限公司资产负债分析

图表 2023年南通富士通微电子股份有限公司利润分配分析

图表 2022-2023年江西联创光电科技股份有限公司偿债能力分析

图表 2022-2023年江西联创光电科技股份有限公司资本结构分析

图表 2022-2023年江西联创光电科技股份有限公司投资收益分析

图表 2022-2023年江西联创光电科技股份有限公司发展能力分析

图表 2022-2023年江西联创光电科技股份有限公司获利能力分析

图表 2022-2023年江西联创光电科技股份有限公司现金流量分析

图表 2022-2023年江西联创光电科技股份有限公司经营效率分析

图表 2023年江西联创光电科技股份有限公司资产负债分析

图表 2023年江西联创光电科技股份有限公司利润分配分析

图表 2022-2023年上海贝岭股份有限公司偿债能力分析

图表 2022-2023年上海贝岭股份有限公司资本结构分析

图表 2022-2023年上海贝岭股份有限公司经营效率分析

图表 2022-2023年上海贝岭股份有限公司获利能力分析

图表 2022-2023年上海贝岭股份有限公司发展能力分析

图表 2022-2023年上海贝岭股份有限公司投资收益分析

图表 2022-2023年上海贝岭股份有限公司现金流量分析

图表 2023年上海贝岭股份有限公司资产负债分析

图表 2023年上海贝岭股份有限公司利润分配分析

图表 2022-2023年天水华天科技股份有限公司获利能力分析

图表 2022-2023年天水华天科技股份有限公司偿债能力分析

图表 2022-2023年天水华天科技股份有限公司资本结构分析

图表 2022-2023年天水华天科技股份有限公司现金流量分析

图表 2022-2023年天水华天科技股份有限公司发展能力分析

图表 2022-2023年天水华天科技股份有限公司经营效率分析

图表 2022-2023年天水华天科技股份有限公司投资收益分析

图表 2023年天水华天科技股份有限公司资产负债分析

图表 2023年天水华天科技股份有限公司利润分配分析

图表 2022-2023年宁波康强电子股份有限公司资本结构分析

图表 2022-2023年宁波康强电子股份有限公司偿债能力分析

图表 2022-2023年宁波康强电子股份有限公司获利能力分析

图表 2022-2023年宁波康强电子股份有限公司经营效率分析

图表 2022-2023年宁波康强电子股份有限公司发展能力分析

图表 2022-2023年宁波康强电子股份有限公司现金流量分析

图表 2022-2023年宁波康强电子股份有限公司投资收益分析

图表 2023年宁波康强电子股份有限公司资产负债分析

图表 2023年宁波康强电子股份有限公司利润分配分析

图表 2022-2023年大恒新纪元科技股份有限公司获利能力分析

图表 2022-2023年大恒新纪元科技股份有限公司偿债能力分析

图表 2022-2023年大恒新纪元科技股份有限公司资本结构分析

图表 2022-2023年大恒新纪元科技股份有限公司经营效率分析

图表 2022-2023年大恒新纪元科技股份有限公司发展能力分析

图表 2022-2023年大恒新纪元科技股份有限公司现金流量分析

图表 2022-2023年大恒新纪元科技股份有限公司投资收益分析

图表 2023年大恒新纪元科技股份有限公司资产负债分析

图表 2023年大恒新纪元科技股份有限公司利润分配分析

略……

订阅“2023-2029年半导体市场深度调查分析及发展前景研究报告”，编号：1390959，

请致电：400 612 8668、010-6618 1099、010-66182099、010-66183099

Email邮箱：kf@Cir.cn

详细内容：<https://www.cir.cn/9/95/BanDaoTiHangYeFenXiBaoGao.html>

了解更多，请访问上述链接，以下无内容！！